

芯电科（深圳）技术有限公司

产品规格书

产品名称：**433/315MHz 无线发射芯片**

产品型号：**XF100S**

客户：_____

确认：_____

日期：_____

1、产品概述

XF100S 型 315/433M 无线发射电路是一款低功耗、高性能、宽工作电压、大输出功率的 433MHz 短距离无线通讯发射机电路，支持 ASK 调制方式，它所有的调谐都可在芯片内自动完成。

XF100S 型 315/433M 无线发射电路片内集成了 PLL 和功率放大器，其中 PLL 为发射机提供载波信号，PLL 采用环形振荡器架构。功率放大器将输入信号进行功率放大，采用漏极开路输出，外接扼流电感结构。应用时采用窄带匹配网络，提高谐波抑制，保证输出信号功率大于 10dBm。XF100S 型 315/433M 无线发射电路采用 SOT23-6L 封装。

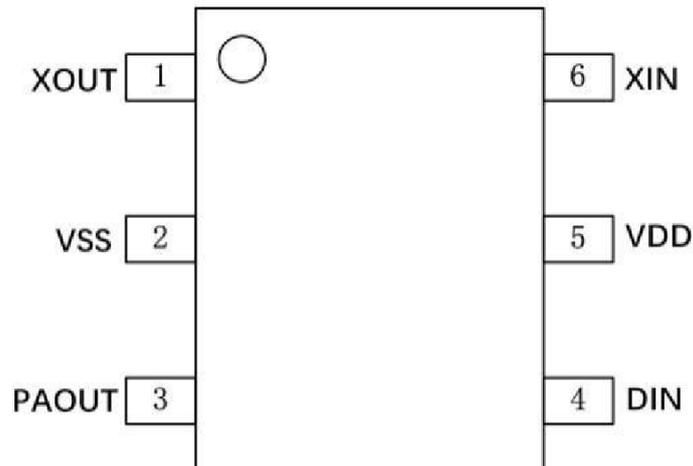
2、特征

- Ø 工作电压范围：DC+1.8V~+3.6V
- Ø 工作频率范围：250MHz~450MHz
- Ø 工作电流大小：17mA/12dBm_433N;18mA/12dBm_315M
- Ø 输出功率大小：≤ 12dBm
- Ø 在关断模式下消耗电流：< 100nA
- Ø 工作温度范围：-40℃~+ 120℃
- Ø 外围器件：极少的外围元器件
- Ø 工作时外接晶体振荡器
- Ø SOT23-6L 封装

3、应用范围

- Ø 遥控门禁系统
- Ø 胎压监测设备
- Ø 遥控风扇、照明开关
- Ø 无线传感数据传输

4、引脚描述



引出端号	符号	功能	引出端号	符号	功能
1	XOUT	参考输出端	4	DIN	数据输入端
2	VSS	地	5	VDD	电源
3	PAOUT	功放输出端	6	XIN	参考输入端

5、电气参数

5.1 绝对最大额定值

参数	最小值	最大值	单位
电源电压	0	4	V
贮存温度	-65	150	°C

5.2 推荐工作条件

参数	最小值	最大值	单位
电源电压	1.8	3.6	V
工作温度	-40	+ 120	°C

5.3 电气特性（除特别说明外，VDD = 3.3V，Tem=25°C）

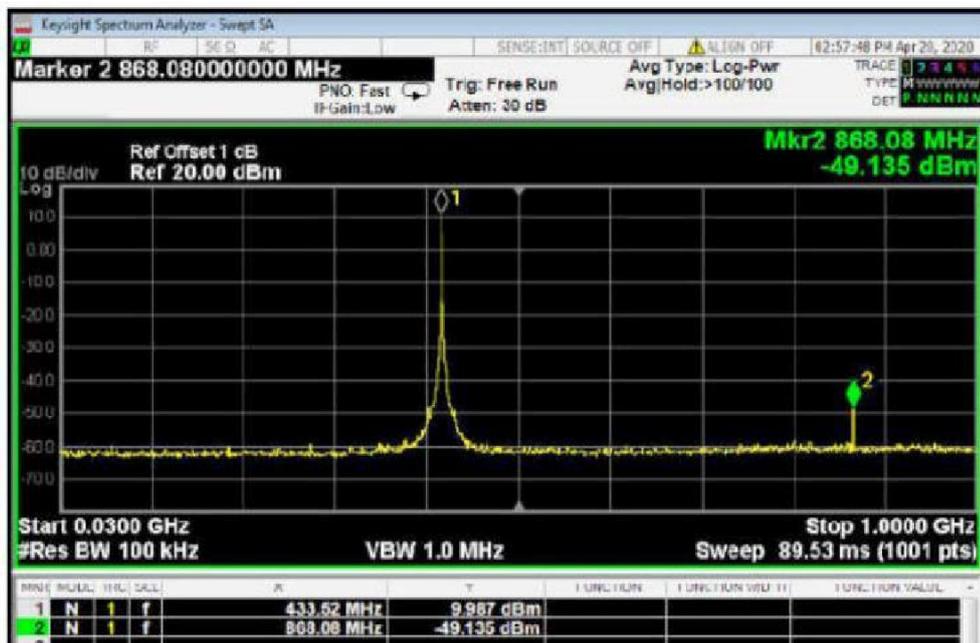
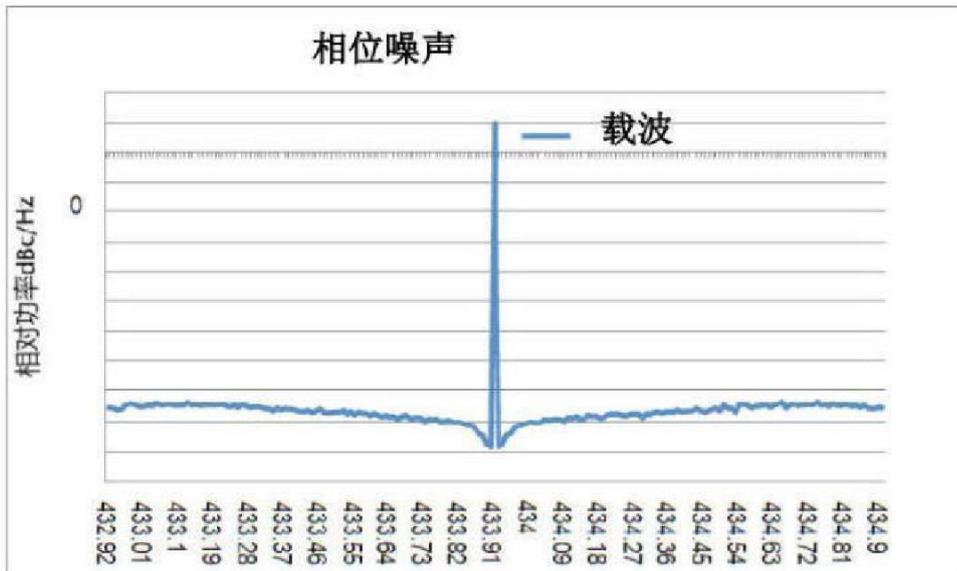
参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
普通特性						
供电电压	V _{DD}		1.8	3.3	3.6	V
工作电流	I _{DD}	@315M,Pout=12dBm		18		mA
		@433M,Pout=12dBm		17		mA
STD 功耗	I _{STD}	DIN=0; Tdelay>40ms			0.1	uA
RF 特性						
支持速率	D _{RATE}		0.5	40		Kbps
频率范围	Freq		250		450	MHz
输出功率	P _{out}	Freq =315M		12		dBm
		Freq =433M		12		dBm
RF 功率开关比	Pon/off	DIN=1 时功率 DIN=0 时功率		60		dB
相位噪声	Freq=433M	10KHz		-90		dBc/Hz
		100MHz		-91		dBc/Hz
		400KHz		-90		dBc/Hz
		1MHz		-87		dBc/Hz
谐波抑制	二次谐波	Freq=433M/Pout=12dBm		-51		dBm
	三次谐波	Freq=433M/Pout=12dBm		-60		dBm
	二次谐波	Freq=315M/Pout=12dBm		-51		dBm
	三次谐波	Freq=315M/Pout=12dBm		-60		dBm
晶振倍频杂散	载波附近	Freq=433M		-55		dBm
		Freq=315M		-55		dBm
晶振特性						

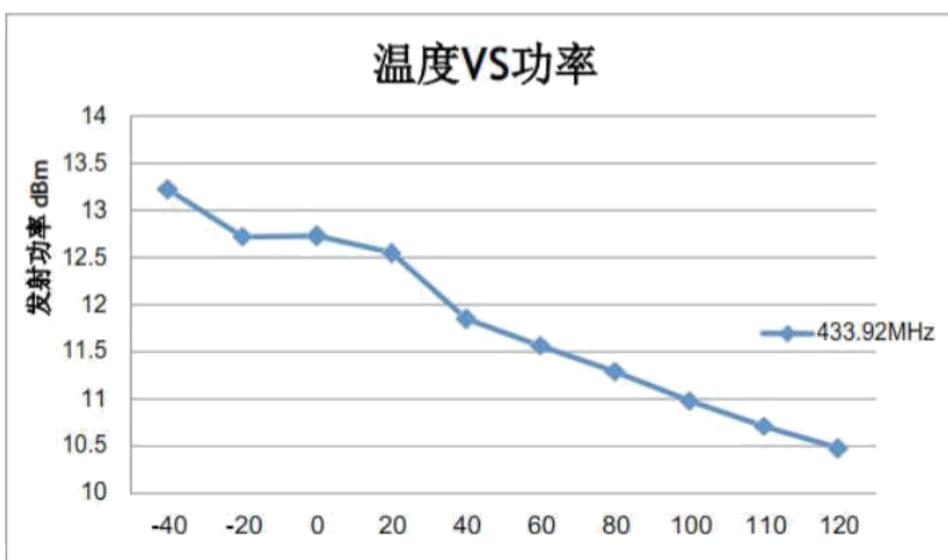
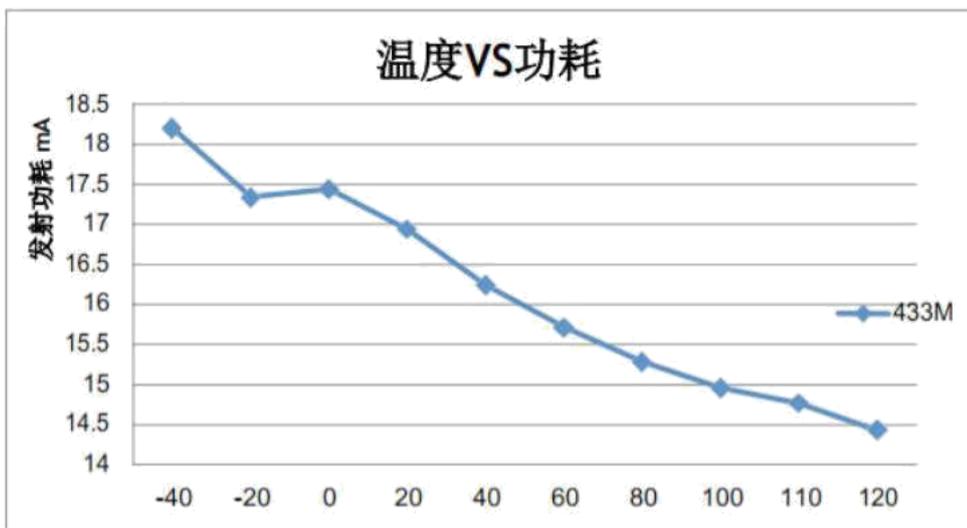
晶振频率	F _{XTAL}	Freq=433M	13.56	MHz
		Freq=315M	9.84375	MHz
负载电容	C _{LOAD}		30	pF
启动时间	T _{ON}	无负载电容	2.3	ms
关闭延时	T _{DELA}		40	ms

6、功能描述

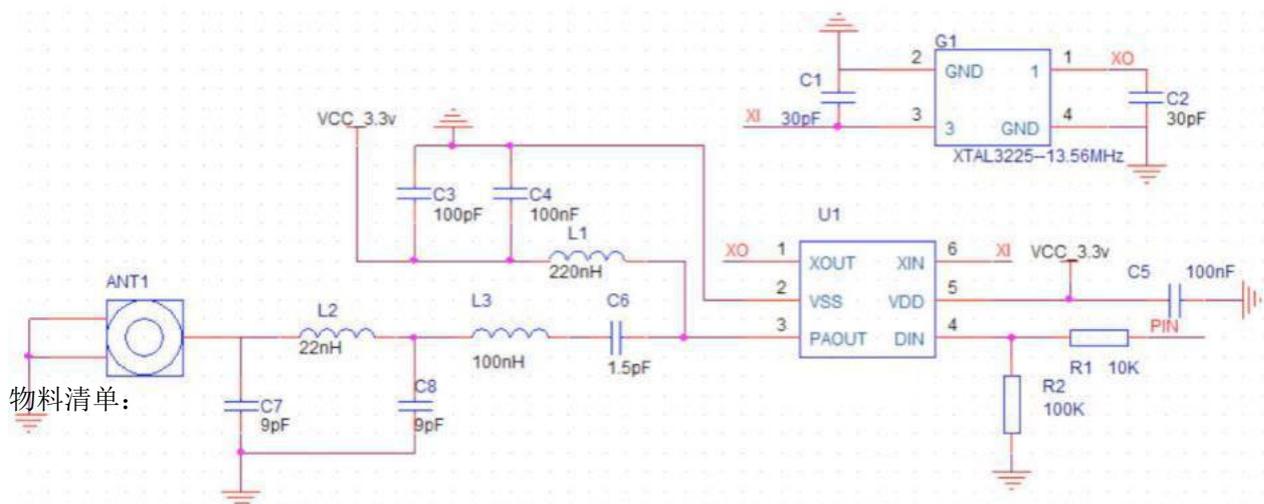
XF100S 短距离无线通讯发射机应用于 315MHz/433MHz 低功耗、低成本短距离收发前端，支持 ASK 调制方式，由频率合成器（PLL）和功率放大器等电路组成。该芯片具有高集成度、低功耗性能，发射功率达到 12dBm。XF100S 内部包含一个使能控制电路，当 DIN=1 时，PLL 与 PA 处于工作状态；当 DIN=0 时，PA 被立刻关断，PLL 经过大约 40ms 的延时后被关断。

7、典型性能图



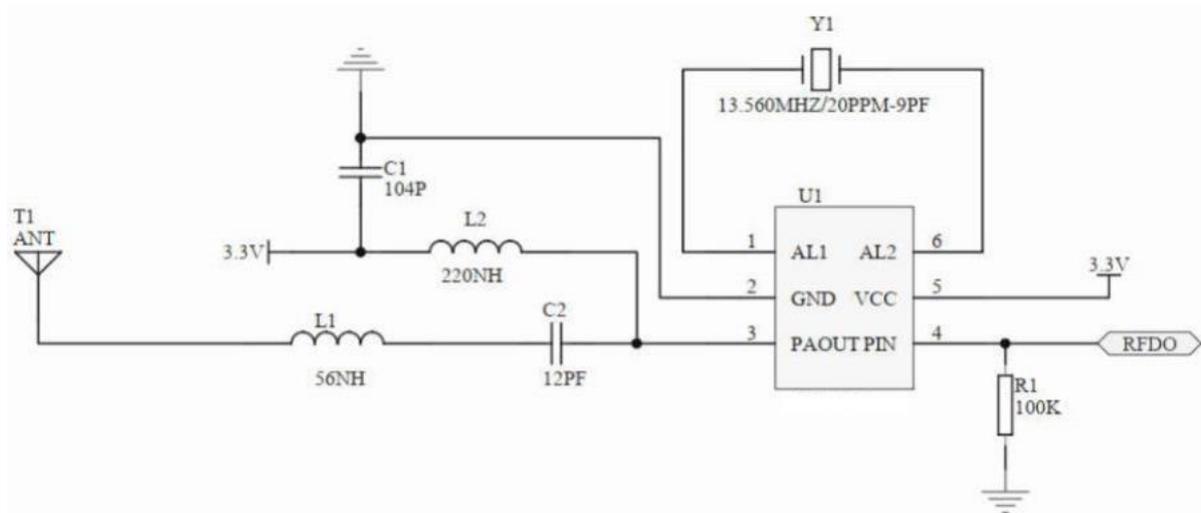


8、FCC/ETSI 认证应用电路

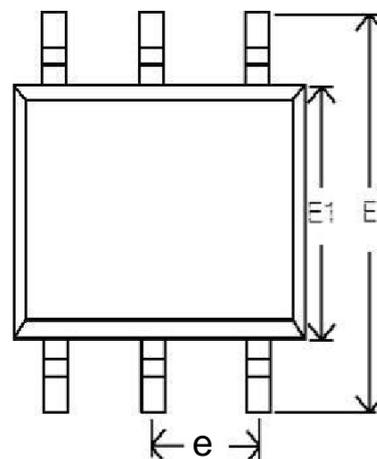
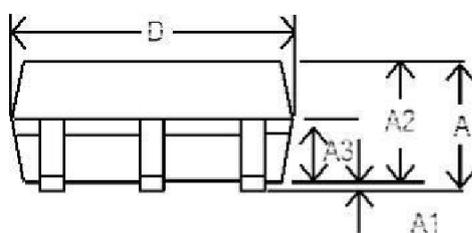


Part	Value		Unit
	315MHz	433.92MHz	
G1	9.84375M	13.56M	Hz
R1	10K	10K	Ω
R2	100K	100K	Ω
C1	22p	30p	F
C2	22p	30p	F
C3	100p	100p	F
C4	100n	100n	F
C5	100n	100n	F
C6	1.5p	1.5p	F
C7	15p	9p	F
C8	15p	9p	F
L1	330n	220n	H
L2 (高频电感)	27n	22n	H
L3 (高频电感)	150n	100n	H

简易电路



9、封装外形



注：单位为毫米

尺寸 符号	数值			尺寸 符号	数值		
	最小	公称	最大		最小	公称	最大
A	—	—	1.35	e	—	0.95	—
A1	—	—	0.15	E	2.60	—	3.00
A2	1.00	—	1.20	E1	1.40	—	1.80
A3	0.55	—	0.75	D	2.72	—	3.12

10、注意事项

- ∅ 接地：金属底板采用尽量多的通孔接地，减小寄生电感。
- ∅ 电源旁路：为了器件能很好工作，电源引线处建议用 0.1 μ F 电容滤波，电容需靠近器件。
- ∅ 防静电损伤：器件为静电敏感器件，传输、装配、测试过程中应采取充分的防静电措施。
- ∅ 用户在使用前应进行外观检查，电路底部、侧面、四周光亮方可进行焊接。如出现氧化可采用去氧化手段对电路进行处理，处理完成电路必须在 4 小时内完成焊接。
- ∅ 包装袋被打开后，元器件将被回流焊制程或其他的高温制程所采用时必须符合：
 - a) 在 12 小时内且工厂环境为温度 < 30 $^{\circ}$ C，湿度 \leq 60%RH 完成；
 - b) 使用前需进行去湿处理（建议 125 $^{\circ}$ C，4 小时烘烤）。
- ∅ 生产贴片的最高炉温为 245 $^{\circ}$ C。
- ∅ 产品说明书以发布日期为准，适时修改不另行说明。

11、存储条件要求

- ∅ 产品必须进行密封真空包装，并建议放置在干燥柜中储存，在温度小于 30 $^{\circ}$ C 且湿度小于 60% 时，可达 12 个月。
- ∅ 打开包装后，如未使用完，则剩余产品需进行抽真空并放置在干燥柜中保管。超期产品使用前必须进行去湿和去氧化处理。